

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. Juli 2005 (14.07.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/063909 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C09J 7/00**,
G06K 19/077

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/053632

(22) Internationales Anmeldedatum:
21. Dezember 2004 (21.12.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 61 541.5 23. Dezember 2003 (23.12.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): TESA AG [DE/DE]; Kst. 9500 - Bf. 645, Quickborn-
strasse 24, 20253 Hamburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HUSEMANN, Marc
[DE/DE]; Strehlowweg 48, 22605 Hamburg (DE).
BARGMANN, Renke [DE/DE]; Hagenbeckstrasse 35,
22527 Hamburg (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: TESA AG; Kst. 9500 - Bf. 645,
Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,
PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ADHESIVE FILM USED TO IMPLANT ELECTRIC MODULES IN A CARD BODY

(54) Bezeichnung: KLEBFOLIE ZUR IMPLANTIERUNG VON ELEKTRISCHEN MODULEN IN EINEN KARTENKÖRPER

(57) Abstract: The invention relates to an adhesive film, comprising a blend made of synthetic rubber S1 and thermoplastics 2 which are used to stick electric modules to chip cards. According to the invention, a) the blend is separated into microphases; b) the blend has at least two softening temperatures, wherein at least one softening temperature is higher than 65 °C and lower than 125 °C; c) a G' measured according to test method A at 23 °C is 10⁷ Pas; d) a G'' measured according to test method A at 23 °C is 10⁶ Pas; e) and a crossover measured according to test method A is less than 125 °C.

(57) Zusammenfassung: Klebstofffolie, bestehend aus einem Blend aus einem synthetischen Kautschuk S1 und einem Thermoplasten 2, wobei a) der Blend mikrophasensepariert ist; b) der Blend mindestens 2 Erweichungstemperaturen besitzt, wobei mindestens eine Erweichungstemperatur grösser 65°C und kleiner 125°C ist; c) einen nach Testmethode A gemessenen G' bei 23°C von größer 10⁷ Pas besitzt; d) einen nach Testmethode A gemessenen G'' bei 23°C von größer 10⁶ Pas besitzt; e) und einen nach Testmethode A gemessenen crossover von kleiner 125°C aufweist zur Verklebung von elektrischen Modulen in Chipkarten.

WO 2005/063909 A1